

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公開番号】特開2003-174117(P2003-174117A)
【公開日】平成15年6月20日(2003.6.20)
【出願番号】特願2001-372737(P2001-372737)
【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 23/12

H 0 1 L 21/56

【F I】

H 0 1 L 23/12 5 0 1 P

H 0 1 L 21/56 E

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月13日(2004.8.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路形成部を形成した半導体素子の回路形成面に形成された突起電極を覆い上記回路形成面に封止材を設けた後、上記回路形成部を保護した状態で上記突起電極が上記封止材に露出するまで上記封止材を除去することを特徴とする電子部品組立方法。

【請求項2】

上記封止材の除去後、上記封止材に露出した上記突起電極の露出面に上記突起電極と導通する導電性材料を設ける、請求項1記載の電子部品組立方法。

【請求項3】

上記封止材を設ける前に、上記回路形成部に接触して該回路形成部を覆い保護する保護材を設ける、請求項1又は2記載の電子部品組立方法。

【請求項4】

半導体素子の回路形成部を形成した回路形成面上に、上記回路形成部に接触して該回路形成部を覆い保護する保護材を設けた後、該保護材を密閉する密閉部材を設けることを特徴とする電子部品組立方法。

【請求項5】

上記密閉部材を設けた後、上記回路形成面上に突起電極を形成する、請求項4記載の電子部品組立方法。

【請求項6】

上記半導体素子は、上記突起電極と電氣的に接続される実装基板上に実装される、請求項1から3、又は5のいずれかに記載の電子部品組立方法。

【請求項7】

上記回路形成部は、半導体ウエハ上に格子状に形成され、上記封止材の除去後、各回路形成部に切り分けられ、上記突起電極と電氣的に接続される実装基板上に実装される、請求項1記載の電子部品組立方法。

【請求項8】

上記回路形成部は、半導体ウエハ上に格子状に形成され、上記回路形成面上への突起電極の形成後、各回路形成部に切り分けられ、実装基板上に実装される、請求項5記載の電子部品組立方法。

【請求項 9】

請求項 1 から 8 のいずれかに記載の電子部品組立方法により組み立てられたことを特徴とする電子部品。